

1 主要用途与主要特点

1.1 主要用途

用 W1XT306P 封装的成品管主要用于 USB、笔记本等电子设备的静电防护。

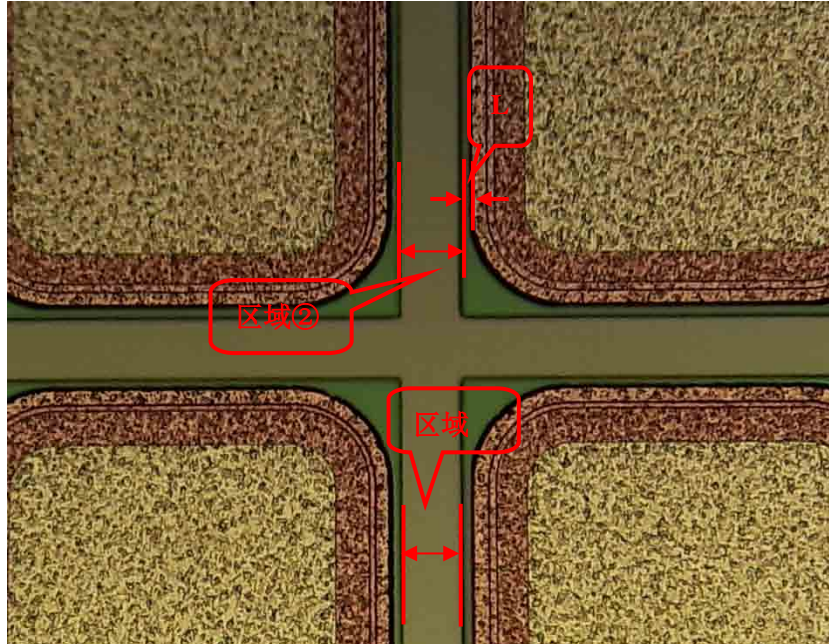
1.2 主要特点

- 低反向漏电
- 高静电防护能力
- 高可靠性

2 芯片数据

	芯片尺寸 (mm×mm)		0.28×0.28	
	芯片厚度 (μm) (推荐)		≤170	
	划片道*尺寸 (μm)		40	
	键合区面积 (μm ²)	正面	180×180	
	正面电极 (阴极)	金属	铝	
		厚度	5.0±1.0	
	背面电极 (阳极)	表层金属	金	银
			装片要求 (推荐)	共晶
	硅片直径 (mm)		φ 125	
	键合要求 (推荐)		铜丝; φ 32 μm; 一	

* 划片道位置示意图:



备注: 区域①为划片刀走刀区域, 划片时应在两条参考线中间; 区域②为划片道区域, 宽度为 40μm; 划片时划片道边缘到铝的距离 L 不小于 5μm 即判定为合格。



3 电特性(在推荐的封装形式、适当的封装条件下)

3.1 极限值

除非另有规定, $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$

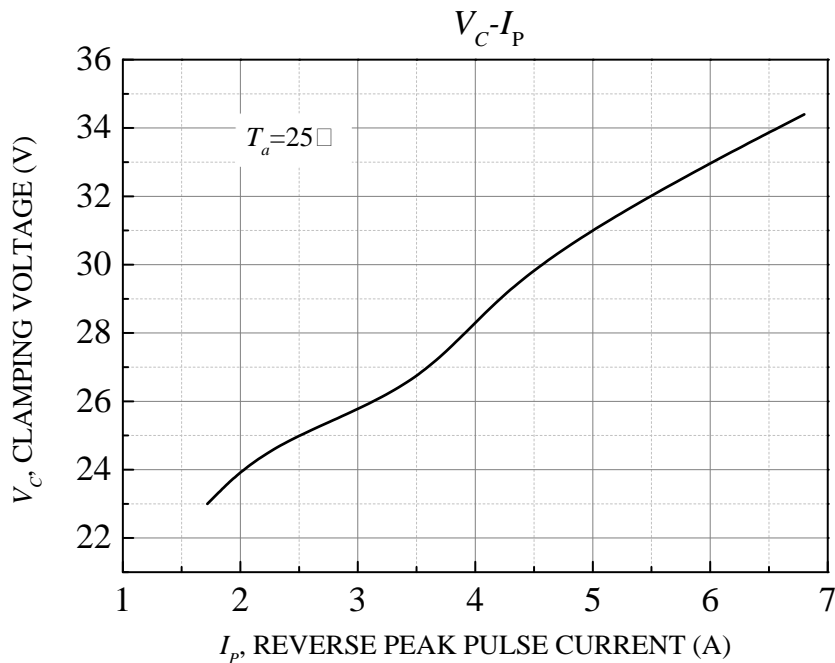
参数名称	符号	额定值	单位	备注
结温	T_j	150	$^{\circ}\text{C}$	推荐封装形式: SOD-523 推荐成品: WS15M2T
贮存温度	T_{stg}	-40~150	$^{\circ}\text{C}$	

3.2 电参数

除非另有规定, $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$

参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
			最小	典型	最大	
击穿电压	V_{BR}	$I_Z=1\text{mA}$	16.7	18	20	V
反向电流	I_R	$V_R=15\text{V}$	—	—	1	μA
正向电压	V_F	$I_F=10\text{mA}$	—	—	0.9	V
钳位电压	V_C	$I_{PP}=5\text{A}$ (8×20us waveform)	—	—	40	V
结电容	C_{tot}	$V_R=0\text{V}$, $f=1\text{MHz}$	—	28	—	pF

3.3 典型特性曲线





江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片
W1XT306P

瞬态电压抑制 (TVS) 二极管

文件编号

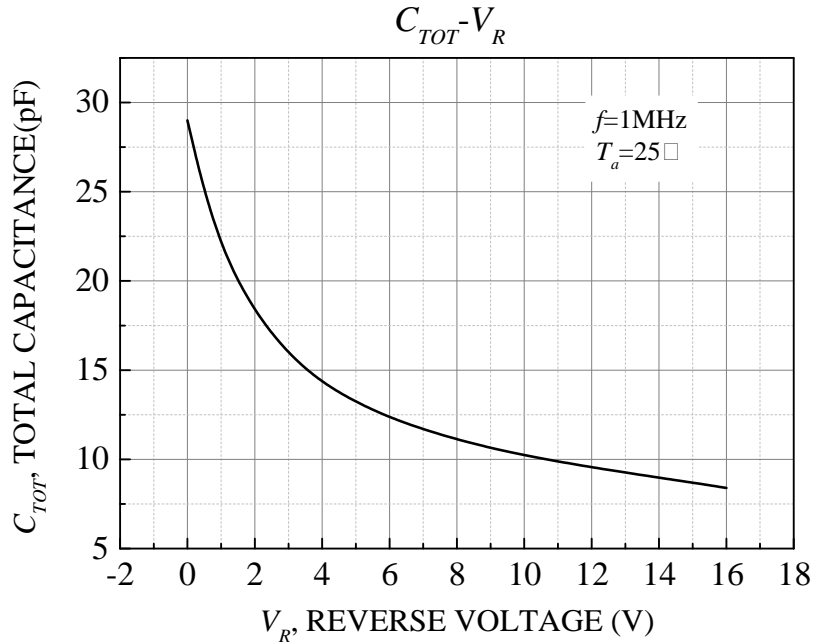
XS-R-266

版本号

18-A2-06

页码

3/3



注意事项:

- 芯片存储条件（推荐）：氮气保护，温度 $25 \pm 5^\circ\text{C}$ ，湿度 $\leq 45\%$ ；
- 本产品说明书仅供参考，不作为合同的一部分，具体以双方签订的技术协议为准；
- 本产品说明书如有版本变更，恕不另行告知！客户在下单前应获取最新版本资料并验证相关信息是否完整和更新；
- 任何半导体产品在特定条件下都有发生失效或故障的可能，买方有责任在使用新顺产品时遵守安全使用标准并采取安全措施，以避免潜在的失效或故障风险造成人身伤害或财产损失的发生。

江阴新顺微电子有限公司

地址：江苏省江阴市长山大道 78 号

网址：[Http://www.xs-elec.com](http://www.xs-elec.com)

电话：(0510) 86851182

传真：(0510) 86851532